温度成層界面ゆらぎにより発生する熱応力の 周波数応答に関する研究

Study on the frequency response mechanisms of thermal stress induced by thermal stratification oscillation phenomenon

東京大学大学院工学系研究科	水谷 崇人	Takato MIZUTANI	
東京大学大学院工学系研究科	ダビッド フォ	David Lucien	
	ウントヴィエス	FUNTOWIEZ	
東京大学大学院工学系研究科	笠原 直人	Naoto KASAHARA	Member

Abstract

The temperature oscillation produced by thermal stratification phenomenon induces thermal fatigue damages on structures of nuclear components, which should be prevented. To evaluate thermal fatigue, the frequency response function was developed. However, this theoretical method does not take particular effects of thermal stratification oscillation into account. To clarify these effects, finite element simulations were conducted with two fluid temperature models. Based on mechanisms of the effects, the frequency response function was improved. Agreement with the results of the finite element simulations confirmed the proposed function.

Keywords: Thermal stratification oscillation, Frequency response function, Finite element simulation, Temperature attenuation

1. 緒言

原子力プラントにおいて冷却材の温度変動によって生 じる熱疲労破損は、近年においても国内外で比較的多く の破損事例が報告されている。原子力システムの安全性 を確保するためには、これを評価し適切に防ぐ必要があ る。

熱疲労破損は熱流動と構造の両分野に亘る複雑な現象 である。冷却材の不規則な温度変動は、配管の構造表面 温度を不規則に変動させる。構造表面温度は熱伝導によ り板厚内部に浸透していくが、その過程で温度振幅の減 衰と時間遅れが生じ、構造内部の温度追従は悪くなる(温 度減衰効果)。この効果は流体温度変動の周波数に依存す る。近年の研究によりこの現象が構造健全性に最も影響 力を持つことが示された[1]。この構造内で発生する温度 減衰効果を考慮し熱疲労破損を評価するために、笠原ら は周波数応答関数を開発した[2-4]。この関数は構造板厚 方向の温度勾配により発生する熱応力を評価する手法で ある。典型的な破損事例である高低温流体合流部の不規

連絡先:水谷崇人、〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1、 東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻 E-mail: takato.s2014@gmail.com 則温度変動による熱疲労はこの周波数応答関数により評価できる。しかしナトリウム冷却高速増殖炉の上部プレ ナムに発生する熱成層化現象[5]のような温度境界面が変動する(温度成層界面ゆらぎ)現象は流体温度が軸方向 分布も持つため、その熱応力を周波数応答関数で適切に 評価することができない。

本研究では温度成層界面ゆらぎ現象による熱応力発生 メカニズムを調べるため、不規則温度変動現象と温度成 層界面ゆらぎ現象を模擬する2つのモデルを作成し、有 限要素法シミュレーションを実施する。得られた結果よ りその熱応力発生メカニズムを解明し、そのメカニズム に基づき周波数応答関数を温度成層界面ゆらぎ現象に対 応するものに改良する。



Fig.1 Thermal stratification oscillation phenomenon in upper plenum of sodium cooled fast breeder reactor [5]

2. 周波数応答関数

流体から構造に熱が伝わる過程で発生する温度減衰効 果と構造内の温度勾配により発生する熱応力は流体温度 ゆらぎの周波数に依存する。構造の周波数応答メカニズ ムを Fig.2 に示す。流体温度ゆらぎが低周波のとき、熱は 構造内で十分拡散し均一な温度分布になるため、大きな 熱応力は発生しない。一方流体温度ゆらぎが高周波のと きも、構造表面への伝熱効果は温度ゆらぎの速度に応答 しきれないために大きな熱応力が発生しない。従って中 間の周波数が最も大きな熱応力を発生させる。



Fig.2 Frequency response characteristics of structures of fluid temperature [3]

周波数応答関数 $G(Bi, jf^*)$ は構造内温度勾配により発生 する熱応力を評価する理論的手法である[2-4]。この関数 は熱伝達関数 $H(Bi, jf^*)$ と熱応力関数 $S(x^*, jf^*, R_m, R_b)$ から構 成される。これらの関数は 1 次元熱伝導方程式をフーリ エ変換することにより得られる。

 $G(x^*, Bi, jf^*, R_m, R_b) = H(Bi, jf^*)S(x^*, jf^*, R_m, R_b)$ (1)

ここで,

 $X^*=x/L$: 無次元板厚方向距離。Lは板厚 Bi=hL/k: ビオ数。熱伝達係数と熱伝導率の比 $f^*=fL^2/a$: 無次元周波数。aは熱拡散率 $R_m R_b$: 膜応力、曲げ応力の拘束率

熱伝達関数 H(Bi,jf)は、流体温度ゆらぎの周波数とビオ 数をパラメーターとし、流体から構造表面への熱伝達過 程を評価する関数である。

$$H(Bi, jf^*) = \frac{Bi}{Bi + \sqrt{\pi f^* + j\sqrt{\pi f^*}}}$$
(2)

一般的に板厚方向応力分布は膜応力、曲げ応力、ピー ク応力に分けられる (Fig.3) [6]。熱応力関数 $S(x^*, jf^*, R_m, R_b)$ は構造表面温度から構造内熱応力への変換を流体温度ゆ らぎの周波数 f^* 、膜応力、曲げ応力の拘束率 R_m, R_b をパラ メーターとして評価する関数である。



Fig.3 Thermal stress divided into membrane, bending , and peak component [6]

$$S(j\omega, R_m, R_b) = -1 + (1 - R_m)(B_m + jC_m) + (1 - R_b)(B_b + jC_b)$$
(3)

$$B_m = \frac{1}{2\sqrt{\pi f^*}} \left[\frac{\sin\sqrt{\pi f^*} \cos\sqrt{\pi f^*} + \sinh\sqrt{\pi f^*} \cosh\sqrt{\pi f^*}}{\cos^2\sqrt{\pi f^*} \cos^2\sqrt{\pi f^*} + \sin^2\sqrt{\pi f^*} \sinh^2\sqrt{\pi f^*}} \right]$$
(4)

$$\mathcal{C}_m = \frac{1}{2\sqrt{\pi f^*}} \left[\frac{\sin\sqrt{\pi f^*}\cos\sqrt{\pi f^*} - \sinh\sqrt{\pi f^*}\cosh\sqrt{\pi f^*}}{\cos^2\sqrt{\pi f^*}\cosh^2\sqrt{\pi f^*} + \sin^2\sqrt{\pi f^*}\sinh^2\sqrt{\pi f^*}} \right]$$
(5)

$$B_{b} = \frac{3}{2\sqrt{\pi f^{*}}} \left[\frac{\sin\sqrt{\pi f^{*}}\cos\sqrt{\pi f^{*}} + \sinh\sqrt{\pi f^{*}}\cosh\sqrt{\pi f^{*}} - \frac{2\sinh\sqrt{\pi f^{*}}\sin\sqrt{\pi f^{*}}}{\sqrt{\pi f^{*}}}}{\cos^{2}\sqrt{\pi f^{*}} + \sin^{2}\sqrt{\pi f^{*}} \sinh^{2}\sqrt{\pi f^{*}}} \right]$$
(6)

$$C_{b} = \frac{3}{2\sqrt{\pi}f^{*}} \left[\frac{\sin\sqrt{\pi}f^{*}\cos\sqrt{\pi}f^{*}} - \sinh\sqrt{\pi}f^{*}\cosh\sqrt{\pi}f^{*}}{\sqrt{\pi}f^{*}} + \frac{2\sinh^{2}\sqrt{\pi}f^{*}\sin^{2}\sqrt{\pi}f^{*}}{\sqrt{\pi}f^{*}}}{\cos^{2}\sqrt{\pi}f^{*}} \cos^{2}\sqrt{\pi}f^{*} + \sin^{2}\sqrt{\pi}f^{*}} \sin^{2}\sqrt{\pi}f^{*}} \right]$$

$$(7)$$

Fig.4 は周波数応答関数により計算された応力のゲイン を示す。前述のように中間の周波数で最大の熱応力が引 き起こされていることがわかる。



Fig.4 Gain of frequency response function of one-dimensional structure

3. 熱成層界面温度ゆらぎの振る舞い

熱成層化現象による温度成層界面ゆらぎの振る舞いを 解析するため、2つの流体温度変動モデルを分析した。 1つ目の流体温度変動モデルは熱成層固定モデル(Fixed layer model)である(Fig.5)。このモデルは流体温度が上 下に分かれ、下方の温度は一定、上方は流体温度が正弦 波状に変動する。前述の周波数応答関数はこのモデルの ように温度変動をする想定で開発された。



Fig.5 Temperature oscillation with the fixed layer model

しかし、現実の熱成層界面温度ゆらぎの振る舞いは上 記モデルよりも複雑である。2つ目の流体温度変動モデル は界面の空間移動を考慮に入れた熱成層移動モデル(The moving layer model)である(Fig.6)。このモデルでは上部を 高温、下部を低温に固定して2層に分け、その境界層が 一定の周波数で正弦波状に移動する。



Fig.6 Temperature oscillation with the moving layer model

この2つのモデルは固定点で観察すると異なった流体 温度変動をする(Fig.7)。熱成層移動モデルの場合、温度 境界層は正弦波状に移動するが、固定点で観察すると矩 形波状に温度変動をする。



Fig.7 Temperature histories at the point of interest for each model

これらの2つの流体温度変動モデルによる熱応力発生 メカニズムの違いを比較するため、有限要素法によるシ ミュレーションを行った。Fig.8 は用いた構造のモデルで ある。素材は316FR、流体-構造間の熱伝達係数は930 W/m²K である。



Fig.8 Mechanical and thermal pipe model

このモデルを用いたシミュレーションから、熱応力の ゲインを計算した。また周波数応答関数を用いて計算し たゲインも合わせて Fig.9 に示す。この結果から周波数応 答関数は熱成層固定モデルのゲインを予測することがで きるが、熱成層移動モデルのゲインは流体温度ゆらぎが 低周波と高周波で熱応力を過小評価することがわかる。



Fig.9 Gains of the frequency response function and finite element simulation results

4. 熱成層界面ゆらぎにより発生する熱応 カの周波数応答メカニズム

3章の Fig.9より、周波数応答関数は熱成層界面ゆらぎ により発生する熱応力を低周波領域と高周波領域で適切 に予測できないことがわかった。そこで2つの温度ゆら ぎモデルにより発生する熱応力の周波数応答メカニズム を調べた。

4.1 低周波領域における熱応力応答メカニズム

まず流体温度ゆらぎが低周波のときの、各モデルの熱 応力応答メカニズムの違いを調べた。

熱応力は主に構造内板厚方向の温度勾配により発生す るので、構造内の温度勾配を調べた。Fig.10 は各モデルに おける構造内部温度の最大値と最小値を示している。温 度勾配においてはモデルによる差異が見られないことか ら、熱応力応答メカニズムの違いは熱伝達過程によるも のではないことがわかる。



Fig.10 Temperature gradient across wall-thickness

よって各モデルにおける熱応力応答メカニズムの違いは 熱応力応答関数 *S(x^{*}, jf^{*}, R_m, R_b)*によるものであることがわ かる。Fig.11 は各モデルの構造表面における応力履歴であ る。熱成層固定モデルの場合圧縮応力のみが働くのに対 し、熱成層移動モデルの場合は圧縮応力と引っ張り応力 の両方が働いていることがわかる。



Fig.11 Stress histories at a point of interest for each model

このことから各モデルの熱応力応答メカニズムの違い を考察する。Fig.12、Fig.13 は各モデルの流体温度ゆらぎ と、軸方向の応力分布を表している。熱成層固定モデル の場合、流体温度が高温のとき圧縮応力が働くのに対し、 低温のときは応力が発生していない。これに対し熱成層 移動モデルの場合は温度境界層の移動に合わせ軸方向の 応力分布も移動するので、圧縮応力に加え引っ張り応力 を受ける。これが各モデルの低周波領域における熱応力 応答メカニズムの違いである。



Fig.12 Steady state thermal stress distribution of the fixed layer model



Fig.13 Steady state thermal stress distribution of the moving layer model

4.2 高周波領域における熱応力応答メカニズム

次に、流体温度ゆらぎが高周波のときの各モデルの熱 応力応答メカニズムの違いを調べた。

Fig.14 は各モデルの構造内板厚方向の温度勾配である。 この図から構造内の温度勾配はモデルによる違いがある ことがわかる。このことから流体温度ゆらぎが高周波の とき熱応力応答メカニズムの違いは流体から構造への熱 伝達過程にあることがわかる。



Fig.14 Temperature gradient across wall-thickness

3 章に示した Fig.7 は構造表面における流体温度履歴で ある。この図から熱成層移動モデルの場合は最高温度と 最低温度により長い時間さらされていることがわかる。 Fig.15 は構造表面における熱流束の時間履歴である。この 図から熱成層移動モデルの方が大きな熱流束を受けてい ることがわかる。したがって流体温度ゆらぎが高周波領 域のときの、熱応力応答メカニズムの違いは熱流束の違 いであることがわかる。



Fig.15 Heat flux histories at the point of interest for each model

5. 熱応力応答メカニズムに基づく周波数応 答関数の改良

4 章までに分析した熱成層移動モデルの熱応力応答メ カニズムに基づき、周波数応答関数を改良する。

5.1 低周波領域における周波数応答関数の改良

まず流体温度ゆらぎが低周波のときを考える。4章の分析から、熱成層移動モデルは熱成層固定モデルに比べ2 倍の応力変動を受けることがわかった。またこのメカニ ズムは熱伝達過程に依らないので、熱応力関数 $S(x^*, j^*, R_m, R_b)$ のみ改良する。

一般的な構造では曲げ応力成分は完全に拘束されている($R_b=1$)。また2章で説明したように、流体温度ゆらぎが低周波のとき熱は構造内で十分拡散するので、板厚方向温度分布は膜成分によるものである。よって熱成層移動モデルは2倍の膜成分の応力を受けていることになるので、修正周波数応答関数として膜拘束を2倍したもの($Rm^*=2 \times R_m$)を提案する。

5.2 高周波領域における周波数応答関数の改良

次に流体温度ゆらぎが高周波のときを考える。4章から、 2つのモデルの違いは熱成層移動モデルの方が大きな熱 流束を受けることであるとわかった。

熱流束は以下のように書ける。

$$q = h(T_{fluid} - T_{surface}) \tag{8}$$

熱成層固定モデルに比べ熱成層移動モデルはより大きな 熱量が構造に伝わり、これが構造表面の温度の差になっ たと考えられる。ここで各モデルでの温度変動1周期に 伝わる総熱量の比 **Φ**_{model}を考える。

$$\Phi_{model} = \frac{Q_{Moving \,Layer}}{Q_{Fixed \,Layer}} \tag{9}$$

$$Q = \int_{T/2}^{T} q dt = h \int_{T/2}^{T} (T_f - T_s) dt$$
 (10)

この Φ_{model} により熱成層移動モデルの構造表面付近の温 度変動を予測することができる。熱成層移動モデルの構 造表面付近の温度は熱成層固定モデルのものの Φ_{model} 倍 になる。発生する熱応力のうち膜応力成分が発生するの は熱が十分拡散した後なので、熱流束の違いは膜応力に 関与しない。また構造内の熱伝導過程は各モデルに違い がないこと、高周波領域における構造表面付近の温度変 動は主にピーク応力成分になることから、修正周波数応 答関数として熱応力関数 $S(x^*, j^*, R_m, R_b)$ のピーク応力を Φ_{model} 倍したものを提案する。

$$T_{surface}(t) = \frac{T_{fluid}}{\sqrt{\left(1 + \frac{k\lambda}{h}\right)^2 + \left(\frac{k\lambda}{h}\right)^2}} \sin(\omega t - \varepsilon)$$
(11)

hは熱伝達係数、kは熱伝導率、aは熱拡散率を示す。ここで

$$\varepsilon = tan^{-1} \left[\frac{1}{\frac{h}{k\lambda} + 1} \right] \tag{12}$$

$$\lambda = \sqrt{\frac{\omega}{2a}} \tag{13}$$

熱成層移動モデルの温度変動をフーリエ級数展開して

$$T_{moving \, layer} = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sin(2k+1) t \quad (14)$$

式(11)と式(14)を式(8)に代入し、それぞれのモデルにお ける1周期に伝わる総熱量を数値計算し、 ϕ_{model} を導出し た(Fig.16)。この結果から

$$\Phi_{model} = 1.5 \tag{15}$$

とした。



Fig.16 Φ_{model} obtained by theoretical method

Fig.17 は有限要素法シミュレーション、改良前の周波数応 答関数、低周波領域と高周波領域それぞれの熱応力応答 メカニズムに基づき改良した周波数応答関数で計算した ゲインを示している。Fig.17 より、修正周波数応答関数は 低周波領域と高周波領域の熱成層移動モデルの熱応力を 精度良く予測できることが確認できる。



Fig.17 Gains of the frequency response function and finite element simulation results

6. 結言

本研究により熱応力を評価する理論解法である周波数 応答関数を、熱成層化現象による温度成層界面ゆらぎに 対応できるように改良した。改良は温度成層界面ゆらぎ による熱応力応答メカニズムに基づいた。熱応力応答メ カニズムは流体温度ゆらぎが低周波領域のときと高周波 領域のときに分け、個々に分析した。

流体温度ゆらぎが低周波のとき、熱成層移動モデルの

場合は2倍の応力変動を受けていることがわかった。低 周波領域のとき発生する熱応力は主に膜応力であること から、膜応力の拘束率を2倍に修正した。流体温度ゆら ぎが高周波のとき、熱成層移動モデルの場合はより多く の熱流束を受けることがわかった。熱流束の違いが熱応 力に及ぼす影響の考察から、ピーク応力成分を1周期に 伝わる総熱量の比である1.5倍とすることで熱応力関数 を改良した。解明した低周波、高周波領域における熱応 力発生メカニズムに基づき改良された周波数応答関数は 有限要素法シミュレーションの結果とよく一致した。

参考文献

- Gelineau, O., 1999, "Review of predictive methods applied to thermal striping problems and recommendations", F06/3, SMiRT15.
- [2] Kasahara, N., 1999, "Structural Response Diagram Approach for Evaluation of Thermal Striping Phenomenon", F05/4, SMiRT15.
- [3] Kasahara, N. and Takasho, H., 2002, "Stress Response Functions to Multi-dimensional Spatial Fluctuations of Fluid Temperature". In pressure vessel and piping codes and standards 2002, Vol.443 of Pressure Vessels and Piping Conference, American Society of Mechanical Engineers. Pressure Vessels and Piping Division, pp.25-32.
- [4] Kasahara, N., Takasho, H. and Ycumpai, A., 2002, "Structural Response Function Approach for Evaluation of Thermal Striping Phenomena", Nuclear Engineering and Design, Vol. 212, No. 13, pp.281-292.
- [5] Chikazawa, N. Y., Aoto, K., Hayafune, H., Ohno, Y., Kotake, S., Toda, M., and Ito, T., 2011, "Conceptual Design for a Large-Scale Japan Sodium-Cooled Fast Reactor (1) Feasibility of Key Technologies", Paper 11278, ICAPP.
- [6] Jones, I., 1995, "The Effect of Various Constraint Conditions in the Frequency Response Model of Thermal Striping", Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, Vol.18, No.4, pp. 489-502.